公司代码：688126 公司简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。经审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为63,847,574.92元；2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-1,507,506,599.58元。经审慎考虑，公司2025年度不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方娜	王艳
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
电话	021-52589038	021-52589038
传真	021-52589196	021-52589196
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一，多年来深耕半导体基础材料领域，主营业务聚焦于半导体硅片及其他高端半导体材料的研发、生产与销售，为下游芯片制造企业提供关键核心材料，是半导体产业链中不可或缺的基础性环节。公司始终将扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为核心发展战略，持续推进技术突破与产能扩张，助力国内半导体产业链自主可控。

公司现已构建起全尺寸、全品类的半导体硅片产品矩阵，覆盖300mm、200mm及以下等尺寸，涵盖抛光片、外延片、SOI硅片等品类，同时布局压电薄膜衬底材料等异质晶圆特色产品，广泛应用于存储、逻辑、射频、图像处理、通用处理器、功率、射频、模拟、分立器件等芯片制造，全面满足下游多维度应用需求。

公司构建了全球化、多元化的客户体系，覆盖国际一流与国内主流芯片制造企业。国际客户包括台积电、联电、意法半导体、威世等全球头部芯片厂商，国内客户涵盖中芯国际、华虹宏力、华润微等主要芯片制造企业，产品远销北美、欧洲、中国大陆、亚洲其他国家和地区，技术与产品获得全球头部客户高度认可。未来，公司将持续聚焦产能扩张与产品高端化，深耕AI芯片、汽车电子、硅光等新兴领域，深化全球化布局，致力于打造具有国际竞争力的半导体硅片企业，为国内半导体产业高质量发展提供有力支撑。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司核心业务为半导体硅片的研发、生产与销售，盈利主要来源于向下游芯片制造企业销售各类半导体硅片产品。公司依托全尺寸、全品类的产品矩阵，通过规模化生产、技术升级优化成本结构，尽管受行业周期性影响和价格承压导致亏损，但随着全球化客户布局的拓展、以及收入的稳定提升，公司的长期、持续发展基础将得以夯实。

2、采购模式

为保障公司产品质量与性能稳定，契合半导体硅片高纯度、高精度的行业要求，公司严格制定供应商选择、审核及动态管理体系，建立了完善的合格供应商名录管理制度。供应商需全面满足经营资质、研发设计能力、技术水平、质量管控体系、生产能力、产品性价比、交货周期及付款周期等多维度标准，经严格审核后方可纳入公司合格供应商名录，且公司会对名录内供应商开展定期审核与动态评价，持续优化供应商结构。截至2025年末，公司已与全球范围内众多优质供应商建立长期、稳定的战略合作关系，保障原材料、生产设备、零部件等核心采购产品的稳定供应，为公司产能扩张与产品品质提升提供坚实支撑。

3、生产模式

公司主要采用"以销定产"的生产模式，结合下游客户订单需求，统筹安排批量生产计划，同时根据市场需求预测、产品迭代周期及客户交付周期，进行少量备货式生产，平衡订单交付效率与库存合理水平，更好地匹配和满足客户的备货需求。在生产管理方面，公司建立了标准化、精细化的生产管理制度，对生产全流程的人员、设备、工艺、质量等关键因素进行严格管控，合理调配生产资源、协调各项生产活动，确保产品质量与交付时效全面满足行业标准及客户个性化需求。生产布局上，公司以自主生产为核心，同时结合市场波动需求和自身产能利用情况，在部分非关键性技术生产环节适当采用外协加工模式作为补充，以最大化释放产能潜力，满足市场需求。

4、销售模式

半导体硅片行业壁垒高、市场集中度高，生产企业与主要下游客户均较为集中，基于行业特性，公司主要采用直接销售模式。针对国内外头部芯片制造企业等主要客户，公司采取主动开发、一对一直接谈判的方式对接需求、获取订单，建立长期稳定的合作关系，保障核心客户资源稳定；针对中小客户及部分区域市场，公司通过少量专业代理商协助开展客户接洽、订单跟进等工作，拓宽客户覆盖范围，优化客户结构。2025年公司产品远销北美、欧洲、中国大陆及亚洲其他国家和地区，全球化销售布局持续完善，进一步提升了市场抗风险能力。

5、研发模式

公司深度践行"产、学、研一体化"研发模式，始终坚持技术创新驱动发展，2025年研发投入约3.54亿元，研发投入占营业收入比例提升至9.52%，较2024年显著提升。公司持续深化与国内顶尖教学科研机构的紧密合作，聚焦产业实际需求开展技术研发，在提升自身核心技术能力的同时，助力中国半导体硅片行业整体技术进步与科研水平提升。在研发方向上，公司将重点加大核心产品相关技术研发投入，聚焦单晶生长、切割、研磨、抛光、外延与SOI等技术领域，特别加强面向射频、硅光、高压等应用的300mm SOI技术研发与工艺优化，持续追赶国际先进水平，同时推进高端产品产业化进程，为公司长期发展筑牢技术壁垒。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

长期以来，半导体行业受下游需求波动、技术迭代周期等因素影响，呈现周期性波动与长期上涨并存的发展态势，半导体硅片作为产业链上游核心基础材料，其行业周期受到半导体整体行业周期的直接影响。根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2016年至2025年间，全球半导体硅片（含SOI）销售额从76.5亿美元上升至126.5亿美元，年均复合增长率达5.75%。2025年，全球半导体市场延续增长态势，AI应用及数据中心基础设施需求成为核心增长动力，但消费类电子、工业电子等传统应用领域仍处于疲软状态，呈现同比微跌趋势，行业复苏呈现明显的结构性分化特征，根据SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group（SMG）发布的硅片行业年终分析报告显示，2025年全球半导体硅片出货面积增长5.8%，达到12,973百万平方英寸（million square inch，MSI），而同期整体销售额同比下滑约1.2%。尽管受AI应用驱动，用于先进逻辑芯片的外延片和用于高带宽存储（HBM）的抛光片需求强劲，推动半导体硅片出货面积恢复增长。但传统半导体应用增长乏力，其需求和价格环境尚未显著改善。

从行业所处阶段来看，全球半导体硅片行业正处于周期筑底、结构升级的关键时期，国内市场依托下游芯片制造企业扩产红利及国产替代加速趋势，仍处于快速发展的成长期，叠加AI、汽车电子、硅光等新兴领域的长期需求拉动，行业长期增长空间广阔。

（2）行业发展的基本特点

半导体硅片行业整体呈现三大核心基本特点：

一是周期性与结构性分化并存，行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势，半导体硅片行业的市场波动与整个半导体行业周期基本同步，同时2025年行业呈现明显的结构性分化——AI应用及算力相关先进制程领域需求旺盛，传统应用领域复苏乏力，这一特征使得不同尺寸、不同类型、面向不同制程应用的半导体硅片市场需求呈现一定差异化。

二是"后摩尔定律时代"下，技术升级与产能扩张成为行业发展的主线。全球半导体产业已进入"后摩尔定律时代"，2nm制程逐步量产，GAA（Gate-All-Around，环绕栅极）架构广泛应用，芯片制程向更先进节点迭代的同时，特种工艺持续创新，市场需求长期呈增长态势；同时，根据SEMI预测，到2028年，全球预计将新建108座晶圆厂，其中亚洲84座，中国独占47座，超过亚洲新增产能的一半；而在22至40纳米主流制程节点，中国产能占比将从2024年的25%提升至2028年的42%。下游产能扩张将持续拉动硅片需求，因此同步推进产能扩充与技术升级，成为产业链各环节企业应对市场挑战、抢占发展先机的核心举措。

三是全球产能扩张与国产替代并行推进，尽管目前国际主要半导体硅片企业均已启动扩产计划，但叠加各国对半导体供应链安全的重视及技术出口管制收紧，国内半导体硅片行业仍将迎来重要发展机遇。2025年，国内半导体硅片行业特别是300mm半导体硅片业务呈现"国产化加速、结构升级、技术攻坚"的关键特征，本土客户加速推进国产供应商认证，国产替代从"单点突破"向"全面开花"演进，公司作为国内龙头企业，也依托这一趋势实现营收稳步增长。

（3）主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键核心原材料，属于典型的技术密集、人才密集型行业，行业技术门槛较高，核心技术壁垒主要体现在工艺精度与质量稳定控制和全流程技术整合两大方面，这一特征在2025年公司技术迭代中愈发凸显。

从技术要求来看，下游芯片制造采用不同的工艺制程，对应不同的特征尺寸和最小线宽，随着半导体制程进入2nm时代，先进工艺和特种工艺技术对半导体硅片的晶体原生缺陷、杂质控制水平、硅片表面及边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等核心技术指标提出了更为严苛的要求。芯片制程技术节点越先进、特征尺寸越小，对半导体硅片各项指标的控制标准越严苛，不同技术节点对应的指标控制参数甚至相差几个数量级，对生产工艺的精细化程度和质量稳定要求极高。

作为国内半导体硅片龙头企业，公司始终坚持技术研发投入，2025年持续加大核心产品相关技术研发力度，研发投入规模和占收入比例持续提高，已全面突破行业核心技术门槛，有力支撑了公司经营发展。公司掌握了半导体硅片生产全流程的多项核心技术，涵盖300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片相关的直拉单晶生长、磁场直拉单晶生长、热场模拟和设计、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐蚀、双面研磨、边缘研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光、硅片清洗、外延等技术，以及SOI制备技术。其中，公司已全面突破了300mm近完美单晶生长、超平坦抛光工艺以及极限表征等关键技术瓶颈，并建立了具有国际化水平的300mm硅材料极限表征体系，强有力支撑了研发工作的快速迭代，保障了公司半导体硅片产品质量与国际先进水平的同步提升，也为公司300mm半导体硅片产能扩张、高端产品产业化提供了坚实技术支撑。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体硅片行业具有典型的寡头垄断格局，长期以来全球市场均被全球前五大硅片厂商牢牢掌控，分别为日本信越化学、日本SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic及韩国SK Siltron。当前，上述五家企业合计占据了全球80%以上的市场份额，形成了技术、产能、客户资源的多重壁垒，尤其在300mm高端硅片领域，长期垄断核心供给，主导行业技术迭代与市场定价，后发企业的市场空间、特别是海外市场空间受到挤压，尽管近年来全球半导体硅片行业出现周期性波动，部分细分领域面临价格压力与库存调整压力，但五大龙头企业的垄断格局尚未出现根本性改变。

公司作为国内领先的半导体硅片企业之一，自成立以来，始终以全球前五大硅片厂商为长远发展目标，依托持续的技术研发与产能扩张，实现业务快速突破，行业地位稳步提升，成为国内半导体硅片领域打破国际垄断、推动国产替代的核心力量，其半导体硅片产品在国内市场占有率位居前列。作为国内领先的半导体硅片企业，公司始终将扩大生产规模、丰富产品结构、持续提高市场占有率作为核心战略目标，同步推进技术升级与产能扩充，逐步缩小与全球龙头企业的差距。报告期内，公司各子公司分别启动多项重点建设项目，聚焦300mm及200mm半导体硅片的技术能力提升与产能扩充，并持续突破高端产品瓶颈，在300mm SOI硅片领域取得阶段性突破，主要产品已完成关键技术研发，进入量产落地与市场验证阶段。

在保持国内领先地位的基础上，公司正加速开拓国际市场，持续巩固与国际头部客户的合作关系，当前，受益于国内下游芯片制造企业扩产红利、国产替代趋势，以及AI、汽车电子、硅光等新兴领域的需求拉动，公司凭借稳定的产品质量、完善的产品矩阵，加速进入国际市场。同时，公司通过子公司Okmetic深耕高端利基市场，进一步完善全球化业务布局，逐步实现从"国内龙头"向"全球参与者"的转型，行业地位持续提升，成为全球半导体硅片行业中不可忽视的中国力量。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，半导体行业在AI需求爆发、国产替代推进、新兴应用渗透的多重驱动下，呈现"结构性景气"特征，行业整体景气度上行但细分领域分化明显。半导体硅片作为产业链核心基础材料，紧跟行业发展步伐，未来发展趋势与全球技术迭代、国内产业需求深度绑定。

半导体行业新技术核心聚焦于先进制程迭代与特种工艺创新，工艺制程持续微缩，推动半导体硅片向高精度技术方向更迭，更低缺陷、更优性能升级。随着半导体制程不断缩小，芯片的制造技术对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度持续降低，对应在半导体硅片制造过程中，对硅片表面平坦度，硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标的控制要求，这些参数直接决定半导体产品的成品率和性能。报告期内，半导体行业技术演进中，半导体硅片技术均呈现"双轨并行"趋势：一是持续沿着摩尔定律向更先进制程突破，聚焦硅片极限精度控制、杂质去除、翘曲度控制等核心技术，满足AI高算力芯片、高端存储芯片的需求；二是特种工艺与材料技术持续创新，SOI硅片、压电薄膜衬底等异质集成类产品市场需求增长，适配车规级、工业级高端应用需求；同时，成熟制程技术持续优化，面向28nm及以上技术节点的半导体硅片将通过工艺改进提升性价比，适配射频器件、传感器、功率器件等海量应用需求，形成"先进制程引领、成熟制程支撑"的技术发展格局。

报告期内，半导体行业新产业布局聚焦于AI算力、汽车电子、光互连、AR等新兴领域，形成多赛道协同的产业格局，半导体硅片作为核心基础材料，产业需求呈现结构性分化与增量突破并存的特征。从细分领域来看，AI大模型商业化加速落地，算力需求呈指数级增长，带动高端存储、先进逻辑芯片需求爆发，进而拉动300mm高端硅片、外延片及存储用抛光片需求持续攀升，成为半导体硅片产业增长的核心引擎；新能源汽车市场持续升温，车规级芯片需求日益增长，面向车规级驱动芯片、电源管理芯片、IGBT、功率器件、图像传感器、MCU等应用的特殊规格产品需求亦大幅提升。此外，国内半导体产业链自主可控进程加速，下游芯片制造企业持续扩产，进一步拉动对半导体硅片产能扩张与产品升级。未来，半导体硅片产业将持续围绕新兴应用场景拓展，形成"高端化、多元化、国产化"发展趋势：AI应用、汽车电子、光通信等新兴领域将持续释放需求，带动300mm高端硅片、SOI硅片等产品需求增长；国产替代持续深化，以公司为代表的国内半导体硅片企业将逐步实现从成熟制程到先进制程的全面突破；产业协同进一步加深，形成从半导体硅片材料、芯片制造到终端应用的全产业链生态，推动产业竞争力提升。

报告期内，半导体及半导体硅片行业新业态主要体现为"结构性景气"凸显、全球化布局与区域化协同并行的特征。行业不再"普涨普跌"，而是呈现明显的分化态势：与AI算力、存储直接相关的硅片细分领域需求旺盛，而传统消费电子需求的硅片需求则呈现温和复苏态势，AI、汽车电子、硅光等领域持续显著增长，将推动硅片产品结构向高端倾斜；此外，行业新业态还体现在"专业化分工与协同创新"深化，半导体硅片企业与下游芯片制造企业、上游设备供应商、科研机构的协同愈发紧密，形成"研发-生产-应用"闭环，协同创新成为核心发展业态。未来，公司将加强与产业链上下游的深度合作，聚焦高端硅片需求开展定制化研发，同时深化"产、学、研一体化"模式，推动技术快速迭代。

报告期内，半导体硅片行业新模式主要聚焦于"定制化服务、智能化生产、全球化运营、生态化布局"四大方向，适配行业结构性变化与产业升级需求。在定制化服务方面，随着下游芯片应用场景日益多元化，公司逐步推出定制化产品与一站式服务，根据客户工艺需求优化硅片技术参数，提供从产品研发、样品送样到批量供应的全流程服务，满足AI、汽车电子、硅光等新兴领域的差异化需求；在智能化生产方面，公司加速推进生产过程智能化升级，引入自动化控制系统、大数据分析等技术，优化晶体生长、切磨抛等核心工序的工艺参数，提升生产效率与产品一致性，提升对客户需求的响应速度；在全球化运营方面，公司采用"本土产能扩张+海外子公司深耕"的模式，一方面依托国内芯片制造企业的扩产红利，扩大本土产能规模，另一方面通过海外子公司拓展高端利基市场，完善全球化客户布局；在生态化布局方面，公司正逐步构建"硅片材料-芯片制造-终端应用"的全产业链生态，通过协同上下游企业，提升技术迭代能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,378,655.79	2,926,984.24	15.43	2,903,175.58
归属于上市公司股东的净资产	1,692,484.08	1,229,926.01	37.61	1,511,434.05
营业收入	371,603.01	338,761.17	9.69	319,030.13
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	367,918.63	332,889.15	10.52	310,823.89
利润总额	-188,851.99	-116,433.85	不适用	17,765.21
归属于上市公司股东的净利润	-150,750.66	-97,053.71	不适用	18,654.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-177,428.43	-124,306.16	不适用	-16,594.39
经营活动产生的现金流量净额	-55,923.98	-78,771.79	不适用	-27,472.74
加权平均净资产收益率（%）	-12.68	-7.07	不适用	1.27
基本每股收益（元／股）	-0.539	-0.353	不适用	0.068
稀释每股收益（元／股）	-0.539	-0.353	不适用	0.068
研发投入占营业收入的比例（%）	9.52	7.88	增加1.64个百分点	6.96

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	80,160.72	89,582.55	94,364.43	107,495.31
归属于上市公司股东的净利润	-20,852.85	-15,800.97	-26,474.18	-87,622.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,986.93	-23,116.50	-34,240.79	-95,084.21
经营活动产生的现金流量净额	-16,649.64	-29,535.32	-36,553.75	26,814.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	80,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,359
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	17.16	0	无	0	国有法人
上海国盛（集团）有限公司	0	546,000,000	16.52	0	无	0	国有法人
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	226,983,180	298,994,701	9.05	226,983,180	无	0	其他
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	-5,657,349	125,183,596	3.79	0	无	0	国有法人
上海新阳半导体材料股份有限公司	-10,588,320	111,545,975	3.38	3,410,283	无	0	境内非国有法人
海富产业投资基金管理有限公司－海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）	104,489,404	104,489,404	3.16	104,489,404	无	0	其他
上海新微科技集团有限公司	-24,691,792	82,460,780	2.50	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-31,891,185	74,763,920	2.26	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,410,515	71,391,502	2.16	20,887,570	无	0	其他
中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	46,623,551	46,623,551	1.41	46,623,551	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	/						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
上海硅产业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	23沪硅K1	240187	2028-11-17	13.4	3.17
上海硅产业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24沪硅产业MTN001	102484726	2029-10-31	5	2.68
上海硅产业集团股份有限公司2025年度第一期中期票据（科创票据）	25沪硅产业MTN001（科创票据）	102581788	2030-04-23	10	2.4

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海硅产业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	2025年度付息4,247.80万元
上海硅产业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	2025年年度付息1340万元。
上海硅产业集团股份有限公司2025年度第一期中期票据（科创票据）	未到期

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	40.33	34.4	5.93
扣除非经常性损益后净利润	-177,428.43	-124,306.16	不适用
EBITDA全部债务比	-0.034	-0.005	不适用
利息保障倍数	-6.98	-5.32	不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入371,603.01万元，较上年同期增长9.69%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-150,750.66万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-177,428.43万元。与上年同期相比，利润数据及相关财务指标受公司产能爬坡阶段固定成本投入高，尚未完全形成规模效应的影响，毛利率承压的同时計提存货的跌价损失压力较大。同时，受200mm及以下尺寸半导体硅片市场需求回升不及预期的影响，公司控股子公司新傲科技和Okmetic的业绩下滑，并导致公司在并购新傲科技和Okmetic时产生的商誉出现减值损失，经测试，2025年度公司计提商誉减值损失约4亿元，对公司相关报告期的利润有较大影响。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-022

上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入（未经审计）36.72亿元，证券业务收入（未经审计）15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

2、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人李萍女士，1998年取得中国注册会计师资格。1994年开始在立信执业，1994年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。李萍女士近三年签署上市公司审计报告5份。

签字会计师陈燕女士，2015年取得中国注册会计师资格。2012年开始在立信执业，2012年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。陈燕女士近三年签署上市公司审计报告1份。

质量控制复核人瞿玉敏女士，2017年取得中国注册会计师资格。2008年开始在立信执业，2008年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。瞿玉敏女士近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度年审计费用为187万元，内控审计费用为25万元，以上费用为含税金额。2026年度审计费用由公司参照市场一般情况，综合考虑参与审计工作项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据本公司2026年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素，与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2026年4月15日，公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了解，认为：在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的意见客观公正，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。因此，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）2026年4月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（三）本次聘任审计机构事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-020

上海硅产业集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）240,038,399股，每股面值人民币1元，募集资金总额为4,999,999,851.17元，扣除各项发行费用53,814,364.71元（不含增值税），实际募集资金净额为4,946,185,486.46元。上述募集资金于2022年2月17日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告。

2021年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2022年2月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	499,999.99
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	5,381.44
二、募集资金净额	494,618.55
减：	
以前年度已使用金额	354,616.90
本年度使用金额	28,044.10
暂时补流金额	0
现金管理金额	120,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	52.40
加：	
募集资金利息收入	16,352.66
三、报告期期末募集资金余额	8,257.80

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

2、2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2140号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司本次募集配套资金发行股份110,440,713股，每股面值人民币1元，募集资金总额为2,104,999,989.78元，扣除各项发行费用26,289,537.46元（不含增值税），实际募集资金净额为2,078,710,452.32元。上述募集资金于2025年12月17日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2025]第ZA15263号验资报告。

截至2025年12月17日，公司向特定对象发行股票募集资金总额人民币2,104,999,989.78元，扣除中国国际金融股份有限公司承销费及财务顾问费合计人民币13,447,500.00元（含增值税），实际收到募集资金2,091,552,489.78元，此款项已于2025年12月17日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。

2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2025年12月17日
本次报告期	2025年12月17日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	210,500.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付中介费用	1,344.75
二、实际收到的募集资金	209,155.25
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	33,369.80
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
加：	
募集资金利息收入	1.16
三、报告期期末募集资金余额	175,786.62

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称"《募集资金使用管理制度》"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2023年11月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024年6月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。2025年8月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，于2022年2月，公司及保荐人分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年5月，公司及保荐人与上海新昇半导体科技有限公司（以下简称"上海新昇"）并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年6月，公司及保荐人与上海新傲科技股份有限公司（以下简称"新傲科技"）并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月，公司及保荐人与上海新昇、上海晶昇新诚半导体科技有限公司（以下简称"晶昇新诚"，后更名为"上海新昇晶投半导体科技有限公司"，以下简称"新昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于2024年5月，公司及保荐人与新傲科技、上海新傲芯翼科技有限公司（以下简称"新傲芯翼"）并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。于2025年12月，公司及独立财务顾问与招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

2021年度向特定对象发行A股股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称			2021年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年2月17日	
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	03004841882	5,616.43	使用中
上海新傲科技股份有限公司	上海银行嘉定支行	03004911414	594.31	使用中
上海新傲芯翼科技有限公司	上海银行嘉定支行	03005771225	2,047.06	使用中
上海硅产业集团股份有限公司	平安银行上海南京西路支行	15981666888880	/	已注销
上海硅产业集团股份有限公司	中国银行上海张江高科技园区支行	457282551286	/	已注销
上海新昇半导体科技有限公司	招商银行上海华灵支行	121921770510806	/	已注销
上海新昇晶投半导体科技有限公司	招商银行上海华灵支行	121945833410718	/	已注销
上海新昇晶科半导体科技有限公司	招商银行上海华灵支行	121945865110918	/	已注销

2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称			2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
募集资金到账时间			2025年12月17日	
上海硅产业集团股份有限公司	招商银行上海华灵支行	121918983010028	175,786.62	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况参见"附表1：2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表"。

2、2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况参见"附表2：2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至2022年5月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,941.99万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至2022年5月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第4117号）。

2022年6月24日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐人于2022年6月24日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》（海通证券股份有限公司现用名：国泰海通证券股份有限公司，下文同）。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司使用募集资金14,941.99万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将14,941.99万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2022年2月17日				
300mm高端硅基材料研发中试项目	214,420.80	14,941.99	14,941.99	2022年6月27日	2022年6月24日

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》，同意项目的原实施主体上海新昇使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后，再由项目的现实施主体新昇晶科使用募集资金对上述款项等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2、2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2025年12月31日，2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过200,000万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。监事会发表了明确同意的独立意见。保荐人出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2025年4月22日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过160,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。监事会发表了明确同意的独立意见。保荐人出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间	2022年2月17日			
200,000	用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等	2024年4月11日	2025年4月11日	2024年4月11日
160,000	用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等	2025年4月22日	2026年4月22日	2025年4月22日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	年化收益率	利息金额
发行名称				2021年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间				2022年2月17日				
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位大额第一千八百八十五M03S	大额存单	120,000.00	2024-10-12	2025-1-12	1.60%	480.00
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位大额第二千〇六十M01S	大额存单	120,000.00	2025-2-24	2025-3-24	1.35%	135.00
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位通知存款	7天通知存款	120,000.00	2025-3-24	2025-4-9	1.15%	61.33
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位定期存款	定期存款	20,000.00	2025-4-25	2025-7-25	1.35%	67.50
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位定期存款	定期存款	100,000.00	2025-4-25	2025-10-25	1.70%	850.00
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位定期存款	定期存款	20,000.00	2025-7-28	2025-10-28	1.20%	60.00
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位定期存款	定期存款	120,000.00	2025-10-28	2026-1-28	1.20%	未到期
上海新傲科技股份有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行"稳进"3号第SDG22401M462B期结构性存款产品 SDG22401M462B	结构性存款	5,000.00	2024-12-5	2025-1-8	1.57%	7.31
上海新傲科技股份有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行"稳进"3号第SDG22501M031B期结构性存款产品 SDG22501M031B	结构性存款	3,000.00	2025-2-11	2025-3-17	1.57%	4.39
上海新傲科技股份有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行"稳进"3号第SDG22501M152B期结构性存款产品 SDG22501M152B	结构性存款	3,000.00	2025-5-8	2025-6-11	1.60%	4.47
上海新傲科技股份有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行"稳进"3号第SDG22501M231B期结构性存款产品 SDG22501M231B	结构性存款	3,000.00	2025-7-1	2025-8-4	1.50%	4.19
上海新傲芯翼科技有限公司	上海银行嘉定支行	单位定期存款	定期存款	18,000.00	2024-10-28	2025-1-27	1.60%	71.20
上海新傲芯翼科技有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行"稳进"3号第SDG22501M031B期结构性存款产品 SDG22501M031B	结构性存款	17,000.00	2025-2-11	2025-3-17	1.57%	24.86
上海新傲芯翼科技有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行"稳进"3号第SDG22503M152A期结构性存款产品 SDG22503M152A	结构性存款	10,000.00	2025-5-8	2025-8-6	1.83%	45.12
上海新傲芯翼科技有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行"稳进"3号第SDG22501M311B期结构性存款产品 SDG22501M311B	结构性存款	10,000.00	2025-8-26	2025-10-13	1.60%	21.04

注：本报告期不存在使用2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

2025年度，公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为546,000万元，累计收回募集资金进行现金管理发生额为569,000万元，实现收益1,836.42万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意控股子公司新傲科技使用募集资金不超过人民币7.65亿元向其控股子公司新傲芯翼实缴注册资本，并自决议通过之日起以募集资金合计向新傲科技、新傲芯翼提供不超过人民币12亿元借款，以专项实施募投项目"300mm高端硅基材料研发中试项目"。监事会发表了明确的同意意见，保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2025年8月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑目前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募投项目"300mm高端硅基材料研发中试项目"的建设期延长至2026年12月。本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向、投资总额和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、变更及增加募投项目实施主体的情况

2022年5月25日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议，并于2022年6月10日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，募投项目"集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目"原实施主体上海新昇以募集资金15亿元投资并控股晶昇新诚（后更名为"新昇晶投"），再由晶昇新诚（后更名为"新昇晶投"）以募集资金15亿元出资参与设立二级控股子公司新昇晶科，并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。由于上述募投项目实施主体变更事项，新昇晶投、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为募集资金专项账户。

2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司增加控股子公司新傲芯翼为募投项目"300mm高端硅基材料研发中试项目"的实施主体，项目实施地点仍为上海。由于上述增加募投项目实施主体的事项，新傲芯翼在上海银行股份有限公司市北分行开设账户作为募集资金专项账户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司向特定对象发行股票募集资金2025年度的存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：截至2025年12月31日，公司发行股份募集配套资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人和独立财务顾问对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附表1：2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票												
募集资金到账日期	2022年2月17日												
本年度投入募集资金总额	28,044.10												
已累计投入募集资金总额	382,661.00												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	/												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目	生产建设	无	150,000	150,000	150,000		154,417.55	4,417.55	102.95	不适用	不适用	不适用	否
300mm高端硅基材料研发中试项目	生产建设	无	200,000	200,000	200,000	28,044.10	83,517.53	-116,482.47	41.76	不适用	不适用	不适用	否
补充流动性资金	补流	无	150,000	144,618.55	144,618.55		144,725.92	107.37	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计			500,000	494,618.55	494,618.55	28,044.10	382,661.00	-111,957.54	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2025年8月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意募投项目"300mm高端硅基材料研发中试项目"的建设期延长至2026年12月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、（二）募投项目先期投入及置换情况"。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	"集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目"结余金额632.05万元，"补充流动性资金"结余金额107.37万元，均系利息收入。300mm高端硅基材料研发中试项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。本报告期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。												
募集资金其他使用情况	详见"三、（八）募集资金使用的其他情况"及"五、变更及增加募投项目实施主体的情况"。												

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括："生产建设"，"研发项目"，"运营管理"，"投资并购"，"补流"，"还贷"，"回购公司股份"，"其他"；"其他"类型，应当注释说明。

附表2：2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金												
募集资金到账日期	2025年12月17日												
本年度投入募集资金总额	34,714.55												
已累计投入募集资金总额	34,714.55												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	/												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	补流	无	175,000	175,000	175,000	0	0	-175,000	0	不适用	不适用	不适用	否
支付本次交易的现金对价及中介机构费用	其他—支付现金对价及中介费用	无	35,500	35,500	35,500	34,714.55	34,714.55	-785.45	97.79	不适用	不适用	不适用	否
合计			210,500	210,500	210,500	34,714.55	34,714.55	-175,785.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、（二）募投项目先期投入及置换情况"。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况	详见"三、（八）募集资金使用的其他情况"。												

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括："生产建设"，"研发项目"，"运营管理"，"投资并购"，"补流"，"还贷"，"回购公司股份"，"其他"；"其他"类型，应当注释说明。

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-019

上海硅产业集团股份有限公司关于2025年年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货、预付款项和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为其中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算，公司2025年计提的各项减值损失总额约为68,970.82万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称	本期计提(转回以"-"列示)金额
信用减值损失	
应收账款	-414.36
其他应收款	12.93
资产减值损失	
商誉	41,096.52
存货	26,142.94
固定资产	1,902.58
无形资产	230.21
合计	68,970.82

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1.商誉减值准备

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，本公司分别对并购Okmetic OY、上海新昇半导体科技有限公司、上海新傲科技股份有限公司所形成的包含商誉资产组进行商誉减值测试，根据可收回金额与包含商誉的资产组或资产组组合账面价值比较，相应计提商誉减值准备。具体金额为：

单位：万元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
合并Okmetic OY所形成的包含商誉的相关资产组	164,827.32	129,873.84	-34,953.48	-34,953.48	13,100.73
合并上海新昇半导体科技有限公司所形成的包含商誉的相关资产组	211,052.69	236,600.00	-	-	-
合并上海新傲科技股份有限公司所形成的包含商誉的相关资产组	134,327.57	91,600.00	-42,727.57	-38,177.93	27,995.79

注：合并Okmetic OY所形成的包含商誉的相关资产组累计计提的商誉减值损失与商誉减值准备的差额为外币折算导致的差异。

2. 固定资产和无形资产减值准备

报告期内公司控股子公司新傲科技综合考虑其受托加工200mmSOI硅片业务的市场情况和客户的合作模式对200mmSOI硅片生产的相关资产组进行了资产减值测试，根据其预计可回收金额需计提约2,025.42万元的减值损失，公司按照构成资产组的主要资产项目的账面价值分摊，需要计提1,795.21万元固定资产减值损失和230.21万元的无形资产减值损失。除此之外，公司对部分无法满足使用要求的设备设施进行了减值测试，根据这部分设备的预计可收回金额计提约107.37万元固定资产减值损失。

3. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司报告期内对存货项目进行减值测试，针对存货成本高于估计售价的硅片产品计提存货跌价损失约26,142.94万元。

4. 坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试，2025年公司需计提的其他应收款项信用减值损失约为12.93万元，转回应收账款信用减值损失约414.36万元。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-018

上海硅产业集团股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度利润分配方案为：不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为63,847,574.92元；2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-1,507,506,599.58元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，虽然2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为正数但当年度归属于上市公司股东的净利润仍为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2025年度拟不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	109,887,087.44
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,507,506,599.58	-970,537,082.04	186,542,762.23
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	63,847,574.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	109,887,087.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-763,833,639.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	109,887,087.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	842,823,883.01		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	10,293,943,103.06		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.19%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《上海硅产业集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688126
公司简称	沪硅产业
公司名称	上海硅产业集团股份有限公司
报告范围	除特别说明外，本报告有关信息数据涵盖沪硅产业及其附属公司，与公司年报范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》编制，同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）等国际权威披露准则。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会。□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为依据公司ESG管理架构，总部各职能部门及子公司向管理层汇报工作成果，并由董事会审议。报告频率为每年一次。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司建立了以董事会为最高决策机构的可持续发展治理体系，统筹负责公司ESG战略、目标制定等事项；公司管理层负责监督、领导公司ESG战略工作规划完成情况；总部各职能部门及子公司负责落实、执行公司ESG工作计划，并定期向管理层汇报工作成果。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	依法纳税、合规经营、安全生产、环境保护；能源管理、绿色产品、绿色办公	公文函件往来、实地考察调研、日常沟通交流、环境数据披露
股东	经营绩效、创新能力、公司战略、信息披露；公司治理、风险管控、回报机制	官方网站、投资者热线、投资者关系邮箱、上证E互动；股东会、业绩说明会、接受调研
客户	研发能力、产品质量、客户服务；履约能力、环境与能源管理	官方网站、展会论坛、技术交流会；实地走访、客户满意度调查
员工	权益保护、职业发展、薪酬福利；员工关怀、民主管理、职业健康与安全生产	职工代表大会、工会活动、团队建设、公司年会；主题活动、投诉建议通道
供应商及合作伙伴	互利共赢、业务合规、共同发展；供应链管理、商业道德	官方网站、供应商大会、招标会、论坛；展会、技术交流、产学研合作
社区、社会	公益支持、支持人才就业、社区发展	捐款、公益活动；社区活动、招聘活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
3	污染物及废弃物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
4	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	保障员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
7	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	研发创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	投资者权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
16	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的生态系统和生物多样性保护、循环经济、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业、科技伦理和反不正当竞争议题识别为不具有重要性的议题，即在财务重要性及影响重要性层面均不具备高度重要性(或重要性较低)。上述议题中，乡村振兴议题公司暂不涉及，故无披露相关内容，已按照《14号指引》在报告中进行解释说明，其余议题已根据实际工作开展情况在报告中正常披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海硅产业集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-023

上海硅产业集团股份有限公司 关于拟减持其他权益工具投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海硅产业集团股份有限公司拟减持所持有的法国上市公司Soitec S.A.的部分股份。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、交易概述

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过全资子公司NSIG Europe Holding S.à r.l.（以下简称"NSIG Europe"）的全资子公司NSIG Sunrise S.à r.l.（以下简称"NSIG Sunrise"）持有法国上市公司Soitec S.A.（以下简称"Soitec"，股票代码SOI.PA）的208.60万股股份，占Soitec总股本的5.84%。

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟减持其他权益工具投资的议案》，基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要，拟择机对持有的Soitec其他权益工具投资进行减持，减持数量不超过1,086,008股（含本数）。若减持计划实施期间Soitec发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，公司将根据其股本变动对减持计划按照相应变动比例进行调整。上述其他权益工具投资减持方式为通过法国巴黎泛欧证券交易所交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持。在前述额度内，授权公司经营管理层具体实施，授权有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东会审议。

二、减持的目的和对公司的影响

本次减持其他权益工具投资是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要而作出的审慎决策。鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司减持上述其他权益工具投资的收益存在较大不确定性，尚无法确切估计减持上述其他权益工具投资对公司业绩的具体影响，公司将根据减持事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-021

上海硅产业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等。

● 投资金额：人民币250,000万元

● 已履行的审议程序：上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过250,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。其中2021年度向特定对象发行A股股票的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过100,000万元（包含本数），2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过150,000万元（包含本数）。

（三）资金来源

本次现金管理来源为公司2021年度向特定对象发行A股股票及2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2022年2月17日		
募集资金总额	499,999.99万元		
募集资金净额	494,618.55万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目	102.95	不适用
	300mm高端硅基材料研发中试项目	41.76	不适用
	补充流动性资金	100.07	不适用
是否影响募投项目实施	□是√否		

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间	2025年12月17日		
募集资金总额	210,500.00万元		
募集资金净额	207,871.05万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	补充流动性资金	0	不适用
	支付本次交易的现金对价及中介机构费用	97.79	不适用
是否影响募投项目实施	□是√否		

（四）投资方式

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等。

公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的理财产品。上述投资产品不得质押。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过160,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下表所示：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	定期存款	260,000.00	260,000.00	1,337.50	0
2	普通大额存单	200,000.00	200,000.00	216.66	0
3	结构性存款	26,000.00	26,000.00	74.83	0
合计				1,628.99	0
最近12个月内单日最高投入金额			133,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			7.86		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）			-88.23		
募集资金总投资额度（万元）			160,000		
目前已使用的投资额度（万元）			0		
尚未使用的投资额度（万元）			160,000		

注1：最近12个月截至目前指2025年4月15日至2026年4月15日；

注2：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

注3：最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度财务报表合并口径归母数据。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过250,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事项的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1.公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2.在实施期间及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司必须严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次使用向特定对象发行股票募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司本次使用向特定对象发行股票募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人和独立财务顾问对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日